

# SOP/TSSOP/QFN32P-DIP32P

## 轉 DIP32P 鍍金轉接板

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 產品說明

板層：2 層板（又稱雙面板或雙層板）正面：SO/ SOIC/SOP32 & QFN32 轉 DIP32（Pitch:1.27mm & 0.5mm 引腳間距：QFN 為 0.5mm SOP 為：1.27mm），背面：MSOP/SSOP/TSSOP32 轉 DIP32（Pitch:0.65mm 引腳間 TSSOP 為：0.65mm）

板材：FR4 板材（採用 KB 公司軍工級 A 級環保板材，軍工品質）該板材的絕緣性，板材的均勻性，銅皮跟板材基材的可靠性並且銅皮不易縮水，板材的阻抗穩定性

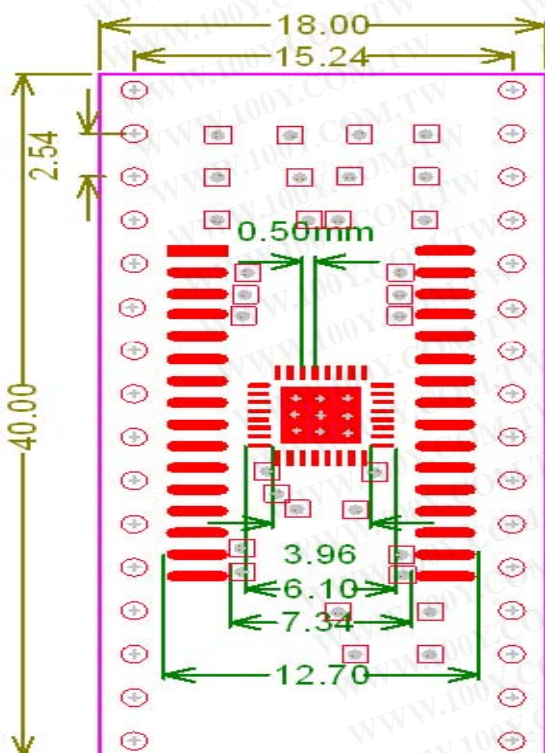
板厚：1.6mm 超厚不易變形

板色：黑油阻焊層與晶片（IC）封裝同顏色更接近晶片封裝

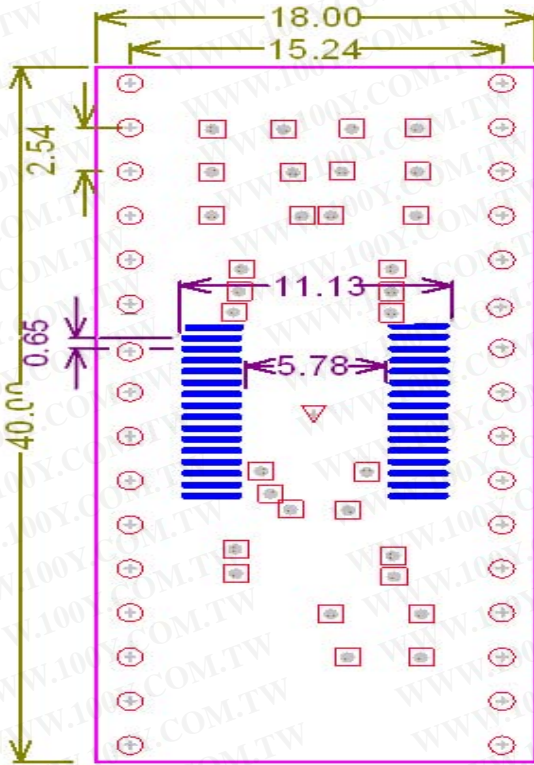
焊盤：採用化學沉金工藝（即焊盤表面鍍金）焊盤與 IC 引腳接觸電阻更小、焊點更牢靠、美觀、防腐蝕、抗氧化、無鉛更環保

轉接板正背面尺寸（如下圖）

<正面>：SO/SOIC/SOP32 & QFN32 焊盤間距 Pitch：1.27mm&0.5mm DIP：2.54mm



<背面>：SSOP/MSOP /TSSOP32 轉 DIP32 焊盤間距 Pitch：0.65mm DIP：2.54mm



【用途】：本轉接板適用於以下“貼片晶片封裝”轉成插件，購買時務必請仔細核對

- SO/SOIC/SOP32 轉 DIP32 Pitch：1.27mm 即：焊盤間距離（引腳間距）<焊接位置：轉接板正面>
- SSOP/MSOP/TSSOP32 轉 DIP32 Pitch：0.65mm 即：焊盤間距離（引腳間距）<焊接位置：轉接板反面>
- QFN32 轉 DIP32 尺寸：Body：Pitch：0.5mm 即：焊盤間距離（引腳間距）<焊接位置：轉接板正面>

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)